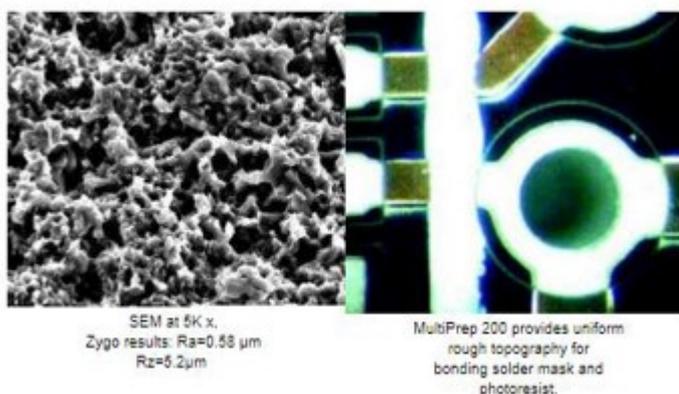


エレクトロニクス

サーキットフォーメーション

レジスト前処理

ソルダーレジスト、ドライフィルムレジスト、液状フォトレジストへの優れた密着性向上処理



MultiPrep

200は、銅表面にソルダーレジスト、ドライフィルムレジスト、液状フォトレジストを密着させる為の優れた前処理プロセスです。

MultiPrep

200は、現在の市場で要求されている樹脂と銅との高密着性に対して、数十年のエッチング剤に対する経験から開発されたプロセスです。製造に於ける効率化、品質均一性向上の為に、砥粒やブラシによる研磨を完全になくします。

MultiPrep

200は、パルスめっきされた基板に於いて、均一で最適な粗化された銅表面形状を提供します。[ENIG](#)、[置換錫めっき](#)、[OSP](#)

、はんだ処理など最終表面処理や実装などに必要となるソルダーレジストの形成前処理として、万能な理想的プロセスです。微細な粗化形状により、ソルダーレジストと銅表面の高信頼性、高耐久性『密着、接着』を可能にします。

PCB製造において、銅と有機フィルムの優れた密着が要求される様々な工程に、MultiPrep 200をお勧めします。

